일반공개용

DAEDUCK

대덕전자 ㈜
2021년 2분기 경영실적

2021.08

Disclaimer

본 자료는 투자자의 투자판단을 위한 참고자료로 작성 된 자료 입니다.
당사는 20년 5월 1일을 기준으로 회사가 분할 되어 신규설립 됨에 따라,
공시기준으로는 20년 5월 이후에 해당하는 실적 부터 확인됩니다.
그러나, 사업회사의 경영은 지속되고 있음을 감안하여, 기존 투자자들의 편의를 도모 코져,
실적 사항은 분할 전 실적을 포함한 사업 연속성 기준으로 작성 되었습니다

또한, 내용에서 언급하는 미래에 대한 예측 정보는 투자자 편의를 위한 참고사항으로,
향후 경영환경과 시장의 변화에 따라 차이가 발생할 수 있음을 양해 바랍니다.

당사는 본 자료의 내용에 있어 투자자에 대하여 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.
또한 당사는 투자자 여러분의 독립적인 판단에 의하여 투자가 이루어 질 것으로 신뢰 합니다.

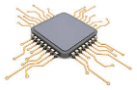
본 자료의 재무자료는 K-IFRS 별도기준 입니다.

회사개요 및 사업소개

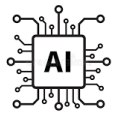
[회사개요]

회사명	대덕전자 ㈜
대표	신영환
설립일	2020년 5월 1일 (회사분할) ※최초설립 : 1972년 8월
신규상장일	2020년 5월 21일
자산규모	8,196억 (2021.06)
임직원수	2,358명 (2021.06)
본사위치	경기도 안산시 단원구 강촌로 230
해외거점	대덕 베트남

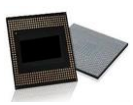
[사업소개]



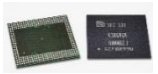
반도체 패키지



AI Processor


AP & Controller

Nand Flash


DRAM

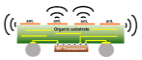
· 메모리 및 비메모리 用 기판

모듈/SiP

Wearable

Sensor

Camera Module


AiP

· 웨어러블, 센서, 모듈 用 기판

MLB

Probe Card

TESTER (semicon)

Repeater

Optical Transmission

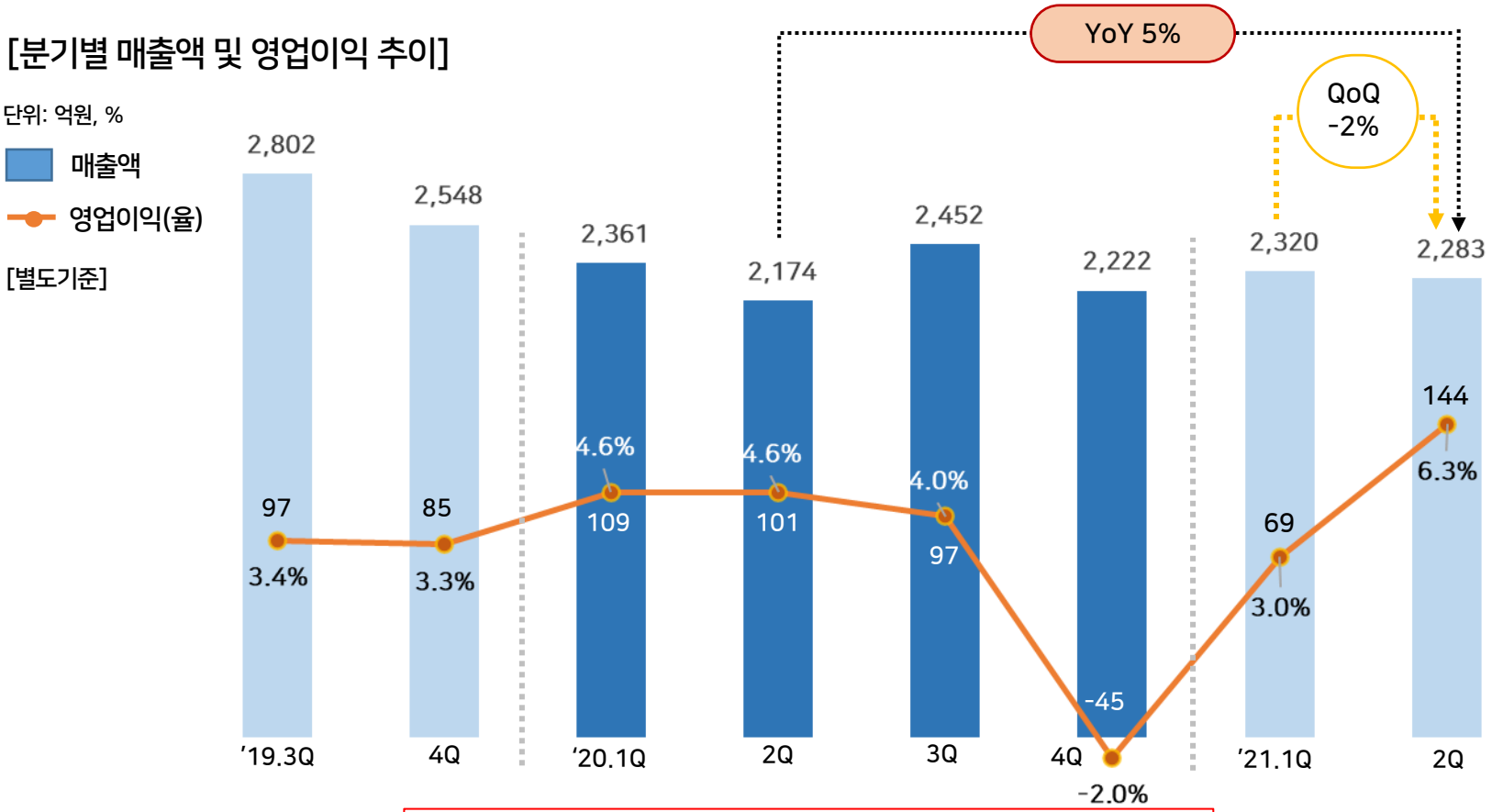
· Tester 및 N/W 用 기판

'21년 2분기 실적

· 매출 : 반도체 시장 확대를 통한 매출 증가로, 단기적 모바일 시장 위축 상쇄

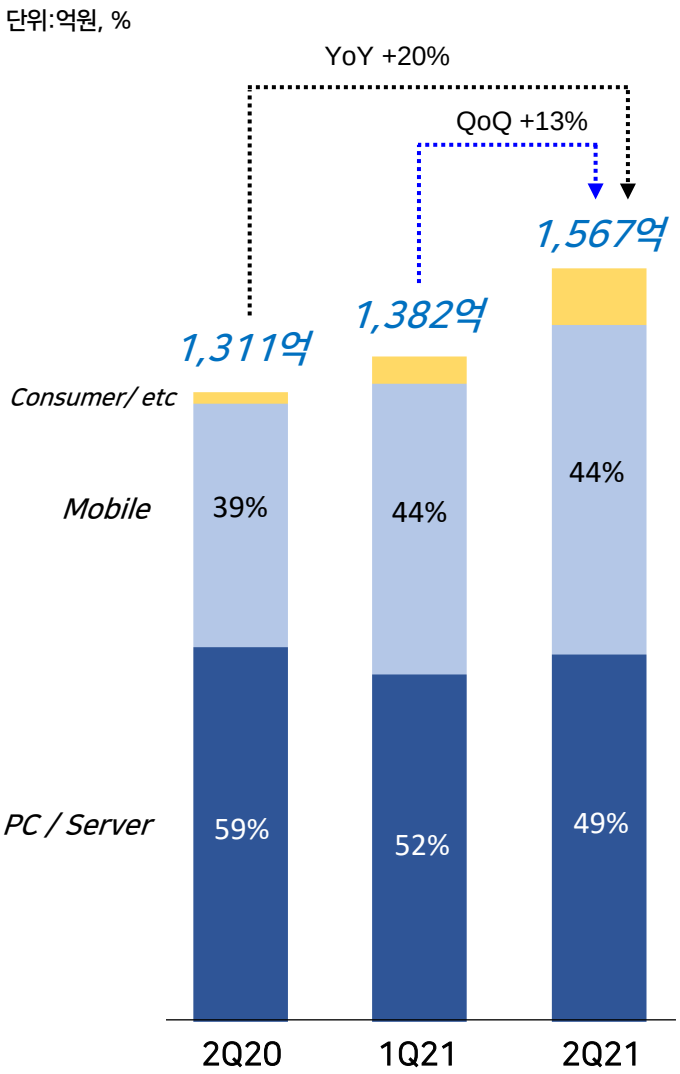
· 손익 : 고부가가치 반도체 제품 확대 및 반도체 관련장비 수요에 따른 이익률 개선

[분기별 매출액 및 영업이익 추이]



※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

반도체 패키지 '21년 2Q 실적 및 3Q 예상



•'21년 2분기 실적

반도체 시장 확대를 통한 실적 개선

- FCBGA 신공장 양산가동
- 글로벌 시장 Marketing 확대
- 고부가가치 반도체 제품 확대

•3분기 예상

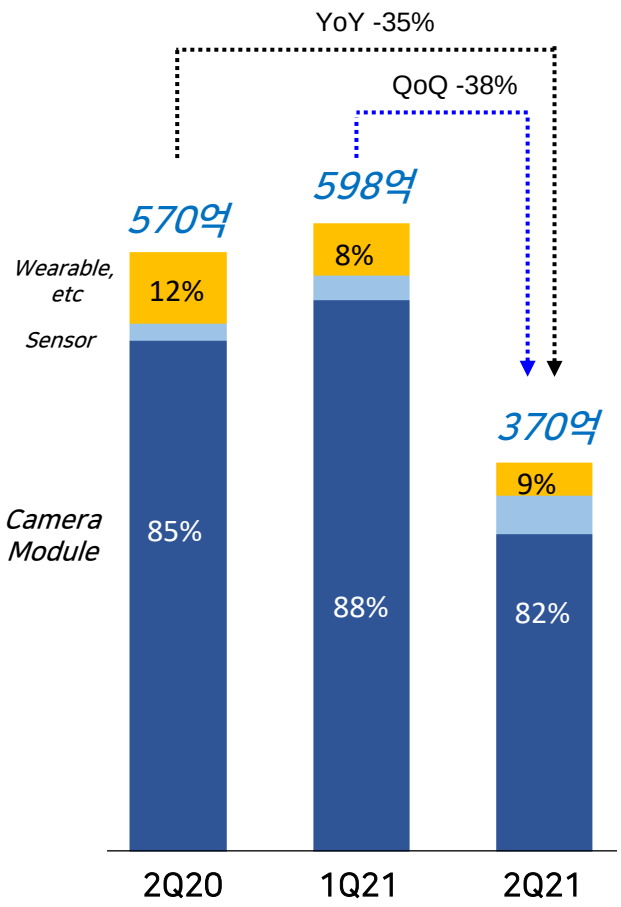
FCBGA 출하를 통한 신규시장 본격 확대

- FCBGA 신공장 양산납품 (매출 START)
- 글로벌 반도체 물량 증가세 지속 전망
- 신제품 확대로 수익 향상 전망

※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

모듈 / SiP '21년 2Q 실적 및 3Q 예상

단위:억원, %



•'21년 2분기 실적

모바일 시장 정체에 따른 단기 위축

- 모바일용 반도체 공급부족 및 신제품 공백에 따라 스마트폰 시장위축 및 물량감소
- 포트폴리오 확대 및 개선활동 지속

•3분기 예상

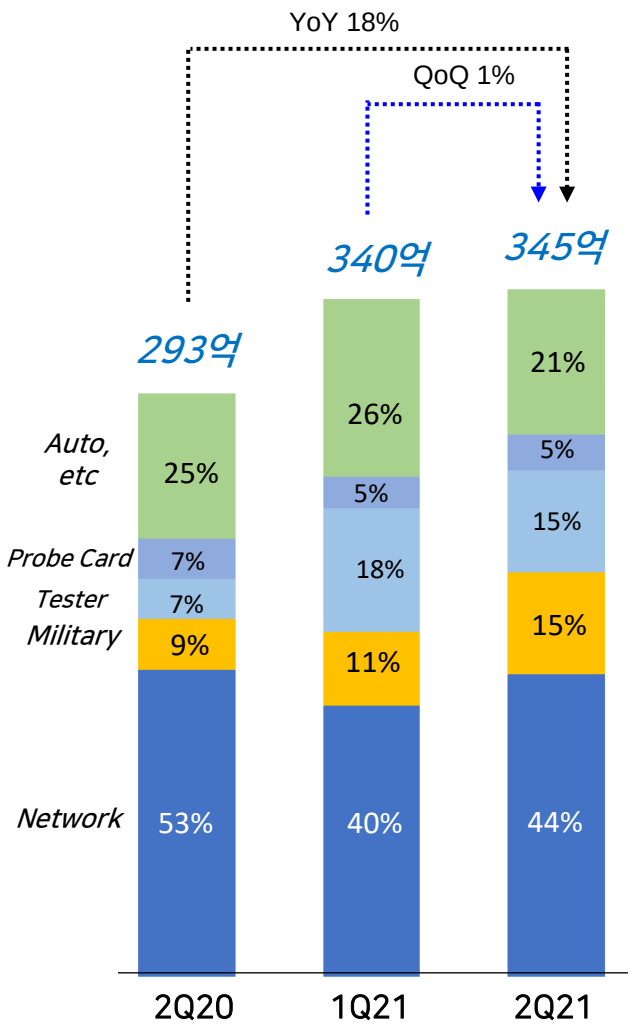
신규제품 확대를 통한 물량 증가

- 전방시장 재고 소진에 따른 시장수요 증가 전망 (스마트폰)
- 포트폴리오 개선을 통한 가동률 향상
- SiP, 반도체 기판 생산 START

※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

MLB '21년 2Q 실적 및 3Q 예상

단위:억원, %



•'21년 2분기 실적

포트폴리오 개선을 통한 '흑자전환'

- 수익 확보를 위한 제품 고부가化
- 글로벌 네트워크 및 방위산업向 물량 확대
- 반도체 관련 장비, 물량 지속 (Tester, Probe Card)

•3분기 예상

반도체 및 N/W向 사업구조 확대 강화

- 광 네트워크 통신용 기판 '전문화' 주력
- 반도체 패키지와 시너지 극대화 (기술융합)

※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

요약재무제표 (별도기준)

[재무상태표]

단위:억원

구분	2020.12 [연간]	2021.03 [1분기]	2021.06 [2분기]
□ 자산총계	7,974억	8,265억	8,196억
유동자산	2,526억	2,745억	2,543억
현금 및 현금성자산	204억	136억	52억
기타 금융상품	2억	2억	2억
매출채권 등	1,362억	1,570억	1,472억
비유동자산	5,448억	5,520억	5,652억
□ 부채총계	1,547억	1,856억	1,678억
유동부채	1,447억	1,730억	1,524억
비유동부채	100억	126억	154억
부채비율	24.1%	29.0%	25.8%
□ 자본총계	6,427억	6,409억	6,516억
자본금	257억	257억	257억

[손익계산서]

단위:억원

구분	2020.12 [연간]	2021.03 [1분기]	2021.06 [2분기]
매출액	6,144억	2,320억	2,283억
반도체 PKG	3,634억	1,382억	1,567억
모듈 / SiP	1,632억	598억	370억
MLB	878억	340억	345억
영업이익	119억	69억	144억
%	1.9%	3.0%	6.3%
세전이익	-120억	103억	140억
당기순이익	-115억	137억	109억
%	-1.9%	5.9%	4.8%
EBITDA	626억	282억	373억
%	10.2%	12.2%	16.3%

※ 2020년 실적은 인적분할에 의해, 20년 5월 이후 8개월 분만 표기됩니다.

ESG 현황

□ 2021년 상반기 종합 'AA' 등급 [서스틴 베스트]

□ 2020년 종합 'A' 등급 [한국기업지배구조원]

- 감사합니다 -